

【原因、判断要点、发生工序】镀铜层表面卷入细微的杂物、或者镀金层基底的镀镍层卷入细微杂物而引起的（镀铜～镀金工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】

The defect is caused by presence of very fine foreign objects on the surface of plated gold or inclusion of the objects in basis nickel plating prior to gold plating (Copper plating - gold plating process)



【コメント】
顕微鏡倍率×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×



【コメント】
顕微鏡倍率×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×

4-2-1-4 金めっき剥がれ／镀金层的剥落 / Peeled gold deposit

【特徴】金めっきがテープテストで剥がれる状態の欠陥

【特征】胶带试验时镀金层剥落的缺陷。

【Characteristics】Gold deposit is peeled off by a tape test.

【原因・判断ポイント・発生工程】金めっき下地表面の汚れや、金めっき条件の管理不適などにより出来たもの（ニッケルめっき～金めっき工程）

【原因、判断要点、发生工序】镀金层的基底玷污、或者镀金条件的管理不善等而引起的（镀镍～镀金工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】

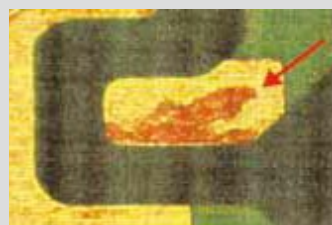
The defect is caused by a dirty basis metal for gold plating or improper control of gold plating conditions (Nickel plating - gold plating)



【コメント】
顕微鏡倍率×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×



【コメント】
顕微鏡倍率× 50

【注釋】
显微镜倍率 × 50

【Comments】
Magnification: ×50

4-2-1-5 金めっきピンホール／镀金层的针孔 / Pinhole in gold deposit

【特徴】金めっきの一部にピンホール状の金めっき不付き部が存在する状態の欠陥

【特征】镀金层的局部有针孔形状的不粘结的缺陷。

【Characteristics】A pinhole-like non-plated spot exists locally in a gold plated area.